

2022年12月19日

各位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村尚史
(コード番号：3446 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理部長 平井靖人
(TEL. 072-655-2785)

プラズマ援用研磨 (PAP) 装置の受注に関するお知らせ

当社は、かねてよりお知らせしておりましたプラズマ援用研磨 (PAP) 装置について受注をしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

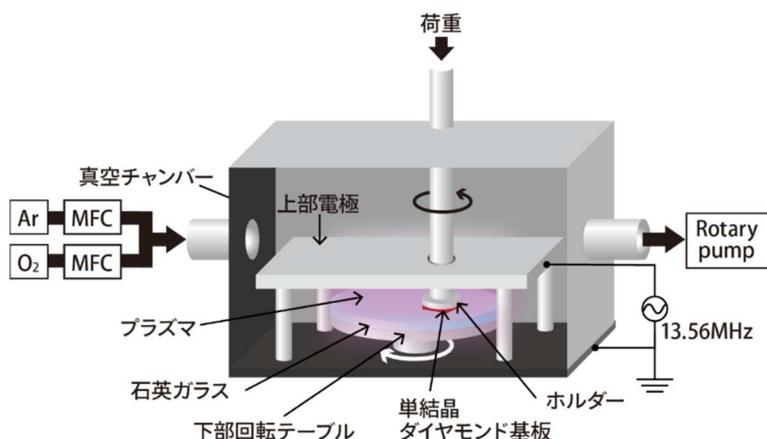
1. 受注の概要

PAP は大阪大学の独自研磨技術であり、次世代半導体材料である SiC や GaN 基板、さらには単結晶ダイヤモンド基板を高速かつ高精度に平坦化*できるため、注目をされております。当社では、これまで複数企業からの引合いがあり、実用化開発を進めておりますが、この度第一号となる PAP 装置の開発機を受注するに至りました。

2. 今後の展開

当社は、12月14日から16日まで開催されました SEMICON Japan の当社ブースにおいて、今回の「プラズマ援用研磨法 (PAP)」だけでなく「Elastic Emission Machining (EEM)」、「触媒基準エッチング法 (CARE)」や「プラズマ化学気相加工法 (Plasma CVM)」等、多数の技術への問い合わせをいただきました。これらの反響に応えるため、今後も独自の半導体向け加工・研磨技術及び装置の開発を推進し、量産化へと展開を図ってまいります。

※ 単結晶ダイヤモンド基板を加工物とする PAP 装置の概略図



以上